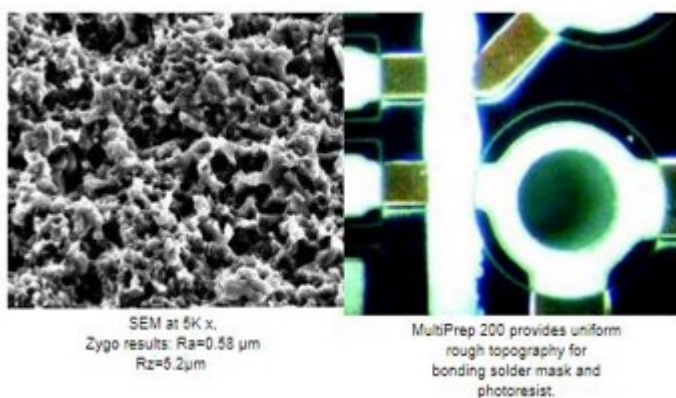


# エレクトロニクス

## サーキットフォーメーション

### レジスト前処理

#### ソルダーレジスト、ドライフィルムレジスト、液状フォトレジストへの優れた密着性向上処理



#### MultiPrep

200は、銅表面にソルダーレジスト、ドライフィルムレジスト、液状フォトレジストを密着させる為の優れた前処理プロセスです。

#### MultiPrep

200は、現在の市場で要求されている樹脂と銅との高密着性に対して、数十年のエッチング剤に対する経験から開発されたプロセスです。製造に於ける効率化、品質均一性向上の為に、砥粒やブラシによる研磨を完全になくします。

#### MultiPrep

200は、パルスめっきされた基板に於いて、均一で最適な粗化された銅表面形状を提供します。[ENIG](#)、[置換錫めっき](#)、[OSP](#)

、はんだ処理など最終表面処理や実装などに必要となるソルダーレジストの形成前処理として、万能な理想的プロセスです。微細な粗化形状により、ソルダーレジストと銅表面の高信頼性、高耐久性『密着、接着』を可能にします。

PCB製造において、銅と有機フィルムの優れた密着が要求される様々な工程に、MultiPrep 200をお勧めします。

## Key Features

- 砥粒やブラシによる研磨を置き換えます。
- 密着性の高い微細粗化形状を形成します。
- 低設備投資
- 浴寿命も長く、管理も容易です。
- 均一な外観を提供します。

### MultiPrep 200

Copper Adhesion Promoter

ソルダーレジスト、ドライフィルム、  
フォトレジストとの優れた接着性

MultiPrep 200は、銅接着性向上処理プロセスは、ソルダーレジスト、ドライフィルム、露光フォトレジストを銅表面に密着させるために理想的な銅表面状態を形成します。

MultiPrep 200は、ジェットスクリブングによる研磨を不要とし、優れた均一な表面状態を提供します。

MultiPrep 200は、優れた酸化処理により、ピエゾフィルムめっきと併用して密着性の高い微細粗化形状と、マイクロピエゾ露光フォトレジストのソルダーレジストの良好な接着性が得られます。

MultiPrep 200プロセスは、ソルダーレジスト塗布に際して塗布剤の揮発性を低減させます。さらに、銅、銀、鉛、ニッケル、銅、亜鉛等を含有するすべての最終塗布剤に適合します。

MultiPrep 200を使用することで、すべての最終用途の銅表面、露光フィルムとの優れた接着の確保が可能です。



#### KEY FEATURES

- 浴寿命が長く、管理も容易。
- 密着性の高い微細粗化形状。
- 均一な外観。

 MacDermid Enthone

CIRCUITRY SOLUTIONS